

# 成都高新区管委会文件

成高管发〔2024〕13号

## 成都高新区管委会 印发《成都高新技术产业开发区 关于支持集成电路产业高质量发展的 若干政策》的通知

各街道办事处，各部门，各区属国有企业：

现将《成都高新技术产业开发区关于支持集成电路产业高质量发展的若干政策》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。



# 成都高新技术产业开发区关于支持 集成电路产业高质量发展的 若干政策

为全面贯彻落实国家、四川省和成都市关于促进集成电路产业高质量发展的决策部署，抢抓集成电路产业发展重大历史机遇，充分发挥链主带动作用，围绕产业链供应链，构建安全稳定、完整可控的集成电路产业生态体系，打造中国集成电路产业第四极，结合实际，特制定本政策。

## 一、适用范围

本政策适用于登记注册、税收关系在成都高新区，具有独立法人资格，从事集成电路设计、制造、封测、设备（零部件）、材料的研发制造应用、专业园区管理服务业务的企事业单位及机构（行业协会、民非组织），以及符合条件的成都市内高校、科研院所。其中，第（五）（六）（七）（十四）条的适用范围拓宽至登记注册、税收关系在成都市其他区（市）县与成都高新区合作共建的园区（以下简称合作园区）内，从事集成电路设备（零部件）、材料研发制造，服务于成都高新区链主企业的配套企业。

## 二、集成电路设计政策

### （一）支持企业加大研发投入。

支持方向一：对 IC（集成电路）设计企业通过国家级公共服务平台租用 EDA（电子设计自动化）工具，按照租赁费用的 50% 给予最高 100 万元补贴。

支持方向二：对设计企业使用多项目晶圆（MPW）进行集成电路产品研发流片的，按照流片费用的 70% 给予最高 500 万元补贴。

支持方向三：对 IC 设计企业开展处理器芯片、通信芯片、感知芯片、功率半导体、存储器芯片、显示驱动芯片等全掩膜（Full Mask）首轮工程产品流片的，按照流片费用的 50% 给予最高 3000 万元补贴。

### （二）支持企业加强生态合作。

支持方向一：对 IC 设计企业围绕产业生态合作，与晶圆代工厂首次签署流片合作协议（一年及以上），且流片量不低于 12000 片/年、24000 片/年的，分别给予 500 万元、800 万元奖励。

支持方向二：对 IC 设计企业围绕产业生态合作，向晶圆代工厂导入产品，且企业流片量不低于 6000 片/年的，按照新产品流片（NTO）费用（含光罩及不超过 200 片晶圆）的 70% 给予最高 3000 万元补贴。

支持方向三：对 IC 设计企业围绕产业生态合作，在晶圆代工厂进行生产流片（不含工程批）的，按照流片费用的 5%

给予每年最高 500 万元补贴。对年出货晶圆数量大于 6 万片的，按“一事一议”原则给予支持。

支持方向四：对 IC 设计企业与封装、测试厂及平台合作开展封装测试的，按照封测费用较上一年度费用增量的 15% 给予最高 100 万元补贴。

### **三、晶圆制造、封装测试政策**

#### **（三）支持企业加大项目投入。**

对新引进的集成电路晶圆制造、封测项目以及企业新建或实施技术升级改造的产线，且上一年固定资产投资超 1000 万元的，按照上一年固定资产实际投资额的 8% 给予最高 2000 万元补贴，单个项目最高不超过 4000 万元。对特别重大的项目，按“一事一议”原则给予支持。

#### **（四）支持企业提升制造、封测服务能力。**

支持方向一：鼓励晶圆制造企业开放产能，为行业企业提供代工流片服务，按照代工费用的 5% 给予最高 1 亿元补贴。

支持方向二：对已量产的封测企业为行业企业提供先进封装及高可靠性封装测试服务的，按照封装测试费用增量的 5% 给予最高 500 万元补贴；对新投产的先进封装及高可靠性封装企业，按照封装测试费用增量的 10% 给予最高 500 万元补贴。

### **四、设备（零部件）、材料政策**

#### （五）加快上下游供应链项目落地。

对成都高新区新备案以及成都高新区协同引进、落地合作园区的设备（零部件）、材料等配套企业，且上一年固定资产投资超 500 万元的，按照上一年固定资产投资额不超过 10% 给予最高 1000 万元补贴，单个项目最高不超过 2000 万元。对特别重大的项目，按照“一事一议”原则给予支持。

#### （六）支持设备、材料验证应用。

支持方向一：鼓励集成电路晶圆制造、封测链主企业开展自主安全可控设备（零部件）、材料验证应用，按照通过验证并应用的设备、零部件、材料产品，分别给予每款 20 万元、10 万元、10 万元的一次性奖励，单个企业每年最高不超过 500 万元。对集成电路设备（零部件）、材料企业产品进入国内外知名企业进行验证的，按照进场验证所产生费用不超过 20% 给予每年最高 200 万元补贴。

支持方向二：企业成功研制集成电路装备首台（套）（新材料首批次）并实现销售的，按照产品首次进入市场实际销售金额不超过 30% 给予最高 3000 万元奖励。

#### （七）支持供应链协同。

支持方向一：对集成电路行业非关联企业之间首次形成设备（零部件）、材料、软件、循环清洗服务等供应链的，按照上年实际购销金额的 10% 给予最高 500 万元补贴（供需双方各 5%）；金额持续增长的，按照上年实际购销金额的 5%

给予最高 500 万元补贴（供需双方各 2.5%），单个企业每年最高不超过 1000 万元，合作园区供方减半支持。

支持方向二：对新建晶圆制造、封测产线，采购国内国际核心原材料，按照产生物流费用的 90% 给予每年最高 3000 万元补贴；采购其他关键原材料、零部件，按照产生物流费用不超过 30% 给予每年最高 1000 万元补贴。

## 五、产业生态跃升政策

### （八）加快培育龙头企业及行业隐形冠军。

支持方向一：对 IC 设计企业年度主营业务收入首次突破 2000 万元、1 亿元、5 亿元、10 亿元、20 亿元的；对晶圆制造、封装测试企业年度主营业务收入首次突破 1 亿元、5 亿元、10 亿元、20 亿元、100 亿元的；对设备（零部件）、材料企业年度主营业务收入首次突破 2000 万元、1 亿元、3 亿元、5 亿元、10 亿元的，按照晋档补差原则分别给予核心团队 100 万元、300 万元、500 万元、800 万元、1000 万元一次性奖励。

支持方向二：对通过“国家鼓励的重点集成电路设计企业”备案的，给予 100 万元一次性奖励。

支持方向三：对首次获评国家级制造业单项冠军示范企业、产品的集成电路企业，分别给予 100 万元、50 万元一次性奖励；对复审通过的，分别给予 50 万元、30 万元一次性奖励。

支持方向四：对首次获评国家级专精特新“小巨人”、省级专精特新的集成电路企业，分别给予 50 万元、30 万元一次性奖励；对复审通过的，分别给予 30 万元、10 万元一次性奖励。

#### （九）支持企业聘用培养关键人才。

支持方向一：对 IC 设计企业人力资源成本支出超过 50 万元以及制造、封测、设备（零部件）、材料企业人力资源成本支出超过 30 万元的高级管理人才和研发人才，按照人才使用效能，分梯度给予企业每人每年最高 50 万元，用于人才绩效奖励。

支持方向二：对企业委托专业机构开展工程师技术能力提升培训的，按照企业实际支付培训费用的 20% 给予最高 50 万元的培训补贴。

#### （十）支持高水平创新平台建设及技术攻关。

支持方向一：对新获批的集成电路领域省级制造业创新中心、产业创新中心、技术创新中心，给予最高 1000 万元一次性奖励。

支持方向二：对国家级创新平台及其参与建设的公共服务平台，为提升服务能力持续投入的，按照平台设备及软件购置费用的 30% 给予最高 1000 万元补贴。

支持方向三：对牵头承担国家集成电路领域重大项目、重大技术攻关计划和重点研发计划的，根据项目国拨资金到

位进度，按照 1:0.5 比例给予单个项目总额最高 2000 万元的配套资金支持。

### （十一）强化产业金融支持。

支持方向一：对企业因特定业务使用供应链金融服务的，按照实际支付手续费的 50% 给予每年最高 100 万元补贴。

支持方向二：对企业因特定业务发生承兑汇票贴现的，按照实际支付利息费用的 50% 给予每年最高 100 万元的贴息补贴。

### （十二）加快打造专业化园区。

支持方向一：对整合区域资源，在专业园区内建设打造具有行业显示度的产业展示中心的企业，给予最高 1000 万元的一次性补贴。

支持方向二：对国家芯火双创基地在专业园区内建设公共服务平台的，给予最高 500 万元的一次性补贴。

支持方向三：对产业展示中心、公共服务平台的运营单位，经评审，分别给予每年最高 300 万元的专项运营补贴。

### （十三）支持资质认证及市场应用。

支持方向一：对首次通过 IATF16949、ISO26262 等体系认证的企业，给予 50 万元/个的一次性奖励。对首次通过 ISO26262 产品功能安全或 AEC-Q 车规级标准认证的芯片产品，给予 10 万元/个的一次性奖励。对材料、零部件、装备企业产品首次通过 SEMI 标准认证的，给予 20 万元/个的一次



性奖励。单个企业每年最高奖励 200 万元。

支持方向二：对终端企业采购非关联行业企业芯片或模组产品，且采购金额在 500 万元以上的，按照采购金额的 10% 给予最高 100 万元补贴（供需双方各 5%），单个企业每年最高补贴 200 万元。

#### （十四）支持产教融合发展。

支持方向一：对企业主导与国际国内高校、科研院所共建集成电路人才实训基地的，按照企业建设投入费用不超过 20% 给予最高 500 万元的一次性补贴。

支持方向二：对市内高校、科研院所将仪器设备等科学装置开放给集成电路行业企业使用的，按照服务费用的 20% 给予最高 300 万元奖励，鼓励将以上奖励资金部分用于对运营团队的个人奖补。

支持方向三：鼓励集成电路企业及市内高校、科研院所开展产业生态合作，围绕材料、设备（零部件）、IP、软件等方向联合研发自主可控产品、技术，对通过晶圆制造、封测链主企业验证的，按照项目自投研发费用的 20% 给予最高 500 万元补贴。

#### （十五）支持提升行业影响力。

对服务集成电路产业，推动区域产业竞争力及行业影响力提升的行业组织，给予每年最高 150 万元奖励。

### 六、附则

（十六）实施细则。

成都高新区电子信息产业局可制定相应的实施细则。

（十七）解释机关。

本政策由成都高新区电子信息产业局承担具体解释工作。

（十八）实施期限。

本政策自 2024 年 7 月 7 日起执行，有效期 3 年。

（十九）其他。

此前发布的相关文件与本文件不一致的，以本文件为准。国家、省、市另有规定的从其规定。本政策与《成都市经济和信息化局等 7 部门关于印发成都市加快集成电路产业高质量发展的若干政策的通知》（成经信发〔2023〕4 号）类似条款（MPW、首轮工程批流片），经审核认定，超出市级支持的部分由成都高新区给予支持。合作园区内企业按照支持标准的 50% 给予支持。同类文件标准不一致的，按照“取高不重复”的原则执行。已享受“一企一策”相关政策的企业不再重复享受本政策类似条款。

信息公开属性：主动公开

---

成都高新区管委会办公室

2024 年 6 月 6 日印发

---